

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2023-019

昇辉智能科技股份有限公司

关于公司及子公司以资产抵押向银行等机构申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司以资产抵押担保方式向银行等机构申请贷款的议案》，为满足公司及子公司生产经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟以资产抵押的方式向银行等机构申请最高不超过人民币 25,169.70 万元账面价值的贷款，具体如下：

单位：万元

项目	资产账面价值（万元）	期限
房产、土地	25,169.70	不超过 6 年
总计	25,169.70	

对公司的影响：

本次以自有资产进行抵押向银行等机构借款系公司及子公司日常经营融资所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响，同时可以优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的影响，是对公司现有资金获取方式进行有益补充，利于公司业务的发展。

本次拟融资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，因未超过公司最近一期经审计总资产的 50%，该事项无需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：

公司及子公司以资产抵押方式向银行等机构申请贷款目的是为调整融资结构，降低融资成本，优化公司资金来源，是公司及子公司日常经营融资所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司

及子公司日常经营产生不利影响。因此，同意公司及子公司以资产抵押的方式向银行等机构申请贷款事项。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日